



Compression Molding System

Model CPM1080series



**Compression molding system
for high-precision WLP/PLP molding processes**



实现高精度WLP/PLP成型工艺的压缩成型设备

- 适用于HBM / 2.5D / 3D / Chiplet 以及 FOWLP / PLP 等先进封装
- 提升模塑厚度的平坦度与真空到达度，实现更高品质的生产
- 以TOWA自主开发的压缩成型技术为核心，支持晶圆级与面板级成型
- 单台设备同时兼容颗粒材料与液态树脂 ※CPM1080-HP设备为颗粒或液态可选式（无法兼用）
- 自研高精度高均匀性颗粒树脂铺撒与图形点胶
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



CPMseries
Wafer type



CPMseries
Panel type



CPM1080-HP

SPECIFICATION

Items		Unit	Description							
机型		—	CPM1080		CPM1080-V		CPM1080-HP			
面板·晶圆类型		—	面板·晶圆							
面板·晶圆尺寸	面板	mm	□150—320							
	晶圆	mm	φ 320 (Max.)							
树脂		—	颗粒·液态 (可并用)				颗粒或液态 (选择式)			
机械时间		sec	Approximately 88		Approximately 88		Approximately 65			
外形尺寸	模组数量	module	1	2	1	2	1	2	3	4
	宽度	mm	3,910	4,590	3,910	4,590	5,490	6,170	6,850	7,530
	纵深	mm	2,180	2,180	2,180	2,180	2,168	2,168	2,168	2,168
	高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	7.0	10.6	7.0	10.6	10.2	13.8	17.4	21.0
每模成形晶圆数量		workpiece	1	2	1	2	1	2	3	4
料盒放置空间		—	Panel : Input / Output 2 cassette each Wafer : 2 loadport							
合模压力		kN/(tf)	98.0—784.0/10.0—80.0							
合模速度		mm/sec	100 (Max.)							
使用分离膜的宽度		mm	440 (Max.)							

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商
- 外形尺寸为颗粒树脂规格的产品



[东和半导体设备（上海）有限公司]

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

TEL 021-6888-6860

[Overseas Sales Contacts]

■ Japan / Headquarters

· TOWA Corporation

■ China

· TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
· Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
· TOWA Taiwan Co., Ltd.

■ Korea

· TOWA Korea Co., Ltd.

■ Singapore

· TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■ Malaysia

· TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■ Thailand

· TOWA THAI COMPANY LIMITED

■ Philippines

· TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■ India

· TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ Germany

· TOWA Europe GmbH

■ Netherlands

· TOWA Europe B.V.

■ the United States

· TOWA USA Corporation

